

北京君正集成电路股份有限公司

关于重大资产重组不构成重组上市的说明

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”）及/或其全资子公司合肥君正拟以发行股份及/或支付现金的方式购买北京矽成半导体有限公司 59.99%股权及上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）100%财产份额（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，其中上市公司控股股东、实际控制人之一刘强或其控制的关联方将认购不低于配套资金的 50%（以下合称为“本次重组”）。

本次重组前，刘强和李杰分别直接持有北京君正 20.12%和 12.79%股份，二人作为一致行动人合计持有北京君正 32.90%股份，为北京君正的控股股东和实际控制人。

在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，按照标的资产暂定交易作价、公司股份发行价格、刘强或其控制的关联方认购配套融资的 50%初步测算，刘强和李杰分别持有北京君正 12.37%和 5.25%股份，合计持有北京君正 17.62%股份，仍为公司控股股东和实际控制人。

因此，在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，北京君正实际控制人不会发生变化，本次重组不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，系《北京君正集成电路股份有限公司关于重大资产重组不构成重组上市的说明》之盖章页）

北京君正集成电路股份有限公司

2019年5月16日